

Express5800/R120h-1M(3rd-Gen)スペック詳細

2020年09月28日版

フレームモデル

製品名称			Express5800/R120h-1M		
モデル名			8x 2.5型ドライブモデル	4x3.5型ドライブモデル	
製品型名			N8100-2834Y	N8100-2835Y	
CPU	Processor	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.90 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Bronze 3206R(8C/8T, 1.90 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4210(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4210R(10C/20T, 2.40 GHz, 13.75MB, TDP 100W), Silver 4214(12C/24T, 2.20 GHz, 16.5MB, TDP 85W), Silver 4214R(12C/24T, 2.40 GHz, 16.5MB, TDP 100W), Silver 4215(8C/16T, 2.50 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4215R(8C/16T, 3.20 GHz, 11MB, TDP 130W), Silver 4216(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 100W), Gold 5215(10C/20T, 2.50 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5217(8C/16T, 3 GHz, 11MB, TDP 115W), Gold 5218(16C/32T, 2.30 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 5218R(20C/40T, 2.10 GHz, 27.5MB, TDP 125W), Gold 5220(18C/36T, 2.20 GHz, 24.75MB, TDP 125W), Gold 5220R(24C/48T, 2.20 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 5222(4C/8T, 3.80 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6226(12C/24T, 2.70 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6226R(16C/32T, 2.90 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6230(20C/40T, 2.10 GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6230R(26C/52T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 6234(8C/16T, 3.30 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6238(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6238R(28C/56T, 2.20 GHz, 38.5MB, TDP 165W), Gold 6240(18C/36T, 2.60 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6242(16C/32T, 2.80 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6242R(20C/40T, 3.10 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6246R(16C/32T, 3.10 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Gold 6248(20C/40T, 2.50 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6248R(24C/48T, 3 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Gold 6252(24C/48T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 6254(18C/36T, 3.10 GHz, 24.75MB, TDP 200W), Gold 6256(12C/24T, 3.60 GHz, 33MB, TDP 205W), Gold 6258R(28C/56T, 2.70 GHz, 38.5MB, TDP 205W), Platinum 8260(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8268(24C/48T, 2.90 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Platinum 8280(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215L(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238L(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240L(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8280L(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W)			
		標準搭載数 / 最大搭載数			
		コントローラ・ハブとの接続			
		インテル® 64			
		インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー			
		インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー			
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー			
		CPUソケット形状			
		ホットプラグ			
		冷却方式			
チップセット					
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトダブルオプション) / Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) DC Persistent DIMM : 6TB(12x 512GB)			
		メモリスロット数			
		増設単位			
		搭載メモリ			
		最大動作周波数			
		メモリバス帯域(チャネルあたり)			
		メモリアクセス方式			
		誤り検出・訂正			
		メモリスベアリング			
		メモリモラーリング			
		ホットプラグ			
		モジュールピン数			
動作電圧					
バッファ機能					
補助記憶装置	ドライブ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ 2x2.5型増設ドライブ(オプション)	4x3.5型ドライブ
			リア	1x2.5型ドライブ(オプション)	
		内蔵標準	2x M.2 SATAスロット (オプション)		
			-		
		内蔵最大	2.5型HDD: SATA 22TB (11x 2TB), SAS 26.4TB (11x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 42.24TB (11x 3.84TB), SAS SSD: 35.2TB (11x3.2TB) (オプションHDDケージ追加時)		3.5型HDD : SATA 48TB(4x 12TB), ニアラインSAS 48TB(4x 12TB) + 2.5型HDD : SATA 2TB(1x 2TB), SAS 2.4TB(1x 2.4TB) 2.5型SSD : SATA 3.84TB(1x 3.84TB) (オプションHDDケージ追加時)
			ホットスワップ	対応	
	インタフェース規格とRAID構成		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)		
	光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1		
	FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB) *2		
	拡張ベイ		-		
	拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (ロープロファイル、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)		
			PCI Express 1.1, 2.0, 3.0		
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB			
	グラフィックス表示 と 解像度	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200			
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 1xUSB2.0(Type A)(N8117-03 内蔵DVDドライブ増設キット 搭載時) 2x USB3.0 (TypeA) , 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45)			
	リア	1x シリアルポート (オプション)			
ネットワーク	内部	2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0			
	実装形式	LOM (必須選択オプション)			
	コントローラ	1x Intel I350 or 1x Intel X550			
	チーミング	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)			
	FEC / GEC	対応			
リモート	ジャンボフレーム	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)			
	PXE / iSCSI ブート	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応			
マネージメント		マネージメント用ポート	BMC		
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)			Marvell PHY		
キーボード / マウス			対応		
BIOS Version (出荷当初)			オプション		
BMC Firmware Revision (出荷当初)			System ROM U32 v2.16 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)		
System Sleep State			1.47 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)		
冗長電源			S0, S5		
冗長ファン			対応 (オプション, ホットプラグ可)		
筐体デザイン			対応 (標準, ホットプラグ可)		
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		434.6mm x 707.0mm x 42.9mm (2.5型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず) 434.6mm x 749.8mm x 42.9mm (3.5型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず)			
質量 (最小 / 最大)		14kg / 28kg (ケーブルアーム無し : 22kg)	14kg / 29kg (ケーブルアーム無し : 25kg)		
電源		選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-160) 800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) (電源ケーブルは必須選択オプション)			
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		908VA / 899W (800W電源最大値) *7			
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		1181VA / 1178W *7	1075VA / 1072W *7		
発熱量		4241KJ/h	3860KJ/h		
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*12		12.8 (区分 2)			
音量		35.9dBA / 45.1dBA			
温度条件		ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床: 0.75m), 環境温度23°C 動作時: 10~35°C(条件付きで5~40°C/45°C対応可) *11, 保管時: -30~60°C 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)			
湿度条件					
ハードウェア認証規定		VCCI クラス A			
OS認証		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware			
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル			
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証			
インストールOS		-			
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.7以降 *5, Red Hat® Enterprise Linux® 8.1以降 *5, VMware ESXi™ 6.5 Update2以降, VMware ESXi™ 6.7 Update2以降, VMware ESXi™ 7.0			
		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います			
動作確認OS *6					

注意事項
拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで、ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで、MD2 = 167.6mmまでを示します

注釈
*1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
*2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」の構成ガイドを参照下さい。
*4 特定構成(2xCPU(Xeon Gold 5118), 2x16GB DIMM, 1xRAIDコントローラ, 1xフレキシブルLOM, 標準ファン, 2x800W電源)での騒音値
*5 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
*6 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
*7 CPU TDPごとの最大電力は8.1.2をご参照ください。
*11 40°C/45°C環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細は「リファレンス」の「40°C/45°C対応についての注意事項」をご参照ください。
*12 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。